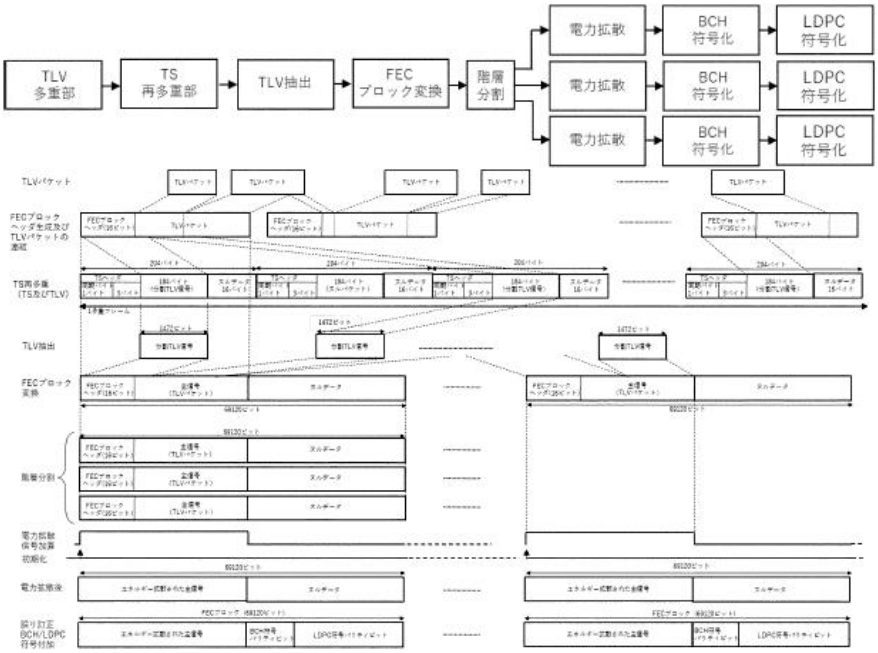
別表第二十号の十八　伝送主信号の構成及び送出手順等(第23条の23第1項関係)



注

1　TS再多重部において、FECブロックヘッダの後にTLVパケットを連結する処理を行う。その後、分割TLV信号(FECブロックヘッダ及びTLVパケットを184バイトごとに分割した信号をいう。以下この表及び別表第二十号の二十において同じ。)を生成する。

2　分割TLV信号にTSヘッダ及び16バイトのヌルデータを付加し、204バイトのTSパケットを構築する。

3　TS再多重部において、多重フレームは、いずれかの階層で伝送されるTSパケット及び伝送主シンボルの生成に用いられないヌルデータの入ったTSパケットにより形成される。

4　TLV抽出は、TS再多重部からの出力から分割TLV信号を抽出する処理をいう。

5　FECブロック変換は、分割TLV信号を束ね、FECブロックヘッダ、主信号及びパリティ部(全てヌルデータとする。)を合わせて69120ビットのFECブロックを構成する処理をいう。

6　FECブロックヘッダは、FECブロックに包含する最初のTLVパケットの先頭位置を示し、FECブロックヘッダを除いたFECブロック先頭からのバイト数で表す。ただし、先頭バイトが存在しない場合、その値は0xFFFFとする。

7　一のFECブロックは、複数のOFDMフレームにまたがってもよく、OFDMフレー

ムにおける先頭のFECブロックの位置は、FECブロックポインタとして階層ごとにTMCC情報の一部として伝送される。

8　FECブロックポインタのポインタ値は、OFDMフレームの先頭から数えて、最初のFECブロックの先頭までの値であり、FECブロックポインタを576で割った値とし、6ビットで伝送される。

9　階層に区分する場合には、FECブロック単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は3とする。

10　電力拡散信号は、別表第十五号別記1のとおりとする。